

**主な質疑応答内容**  
(2014年5月7日実施)

**【業績予想全般】**

Q：2015年3月期（今期）予想の営業利益と事業利益の差が2014年3月期（当期）に比較し拡大した要因は。

A：営業利益と事業利益の差が、当期137億円で、今期予想は197億円であり、約60億円増加している。この60億円には、本社が負担する事業拡大に伴うITシステム関連費用とブランド力を高めるための広告宣伝費、さらに人件費の増加等を見込んでいる。

**【半導体部品関連事業】**

Q：今期のスマートフォン向けセラミックパッケージの売上拡大策を教えてください。

A：スマートフォン向けカメラ用パッケージのシェアを上げていく。スマートフォン向けカメラ用セラミックパッケージのシェアは2割程度で、残りは有機パッケージ。これをセラミックパッケージに置き換えていく。カメラ用セラミックパッケージ全体で10%以上増やしていきたい。

また、水晶/SAWデバイス用セラミックパッケージはLTEの普及により、スマートフォンの高級機も増加し、部品の員数も増えることから、5~6%程度は増加すると考えている。加えて、LED用や光通信向けのパッケージの増加を見込んでいる。

Q：今期、セラミックパッケージは10%の増収を目指すとのことだが、有機パッケージからの置き換え等で従来製品以外の貢献はあるのか。有機パッケージについては、京セラサーキットソリューションズ及び綾部新工場の利益貢献があるのか。

A：セラミックパッケージについては、スマートフォン向けの増加に加え、車載のヘッドライト用にLED用パッケージが増える見通し。車のヘッドライトはLEDに置き換わってきており、一層の採用を促していきたい。

有機パッケージについては、京セラサーキットソリューションズは今期から本格的に収益貢献できるように取り組んでいる。綾部新工場は今夏に完成する。減価償却費などの費用増はあるものの、利益は出せると考えている。

Q：LED用パッケージへの投資の必要性は。

A：LED用パッケージは水晶/SAW用パッケージと製造方法がほぼ同じ。新たに工場を建設するといった大型投資は必要ない。既存の中国やベトナム工場への設備導入で対応可能。

Q：綾部新工場を建設し、携帯電話のアプリケーションプロセッサ向けに FCCSP を増産する計画だが、今後どのように拡大していくのか。

A：これまで有機パッケージ事業は、インフラ系のサーバーやルーター向けを中心に展開してきた。更なる事業拡大を図るために、規模の大きい FCCSP 市場へ展開していくこととした。FCCSP を本格的に拡大させていくには十分な生産容量が必要であり、綾部新工場を建設した。大手メーカーを含め複数客先への展開を図る。

#### 【ソーラーエネルギー事業】

Q：今期のファインセラミック応用品関連事業の利益が、当期に比較して減益となる要因は何か。また、今後も減益が続くのか。

A：太陽電池の価格下落が減益の主要因。太陽電池は 10%近い価格下落を見込んでいる。中期的に単価下落は継続すると思うが、今後も原価低減等、収益性の改善に努め、利益率を維持したい。

Q：ソーラーエネルギー事業の海外市場での展開について、国内同様、パネルに加え、システムや工事まで手がける垂直統合型のビジネスモデルで展開していくのか。

A：ソーラーエネルギー事業は現在、国内中心だが、海外でも積極的に展開していこうと考えている。米国、中東、アジア諸国では需要増加が見込まれ、国内同様にパネル売りだけでなくシステムも含めて展開していきたい。

#### 【電子デバイス関連事業】

Q：液晶ディスプレイ事業は買収により技術を取り込んできたが、現在は目標に向けてどのような状況にあり、今後はどのように事業を展開していくのか。

A：液晶ディスプレイ事業は、オプトレクスを買収した後、車載用・産業用液晶に注力することとした。現在、自動車の新モデル向け製品の受注獲得に努めている。現在試作を獲得している製品は 2017 年 3 月期から一部貢献を始めると考えている。それまでの間は大幅な売上増は厳しいが、それ以降は拡大できる見通し。今後はグループの総合力を活かし、ソフト面も強化していく必要がある。

以上